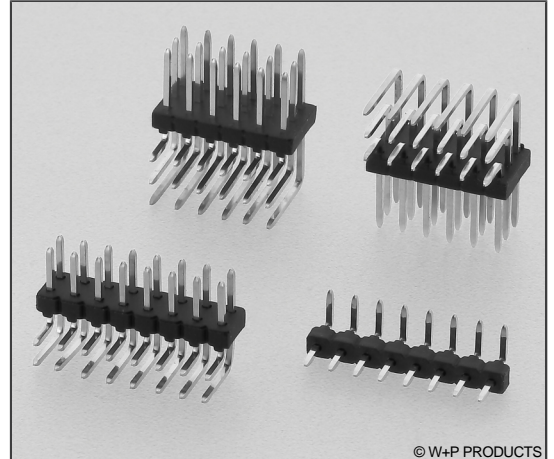


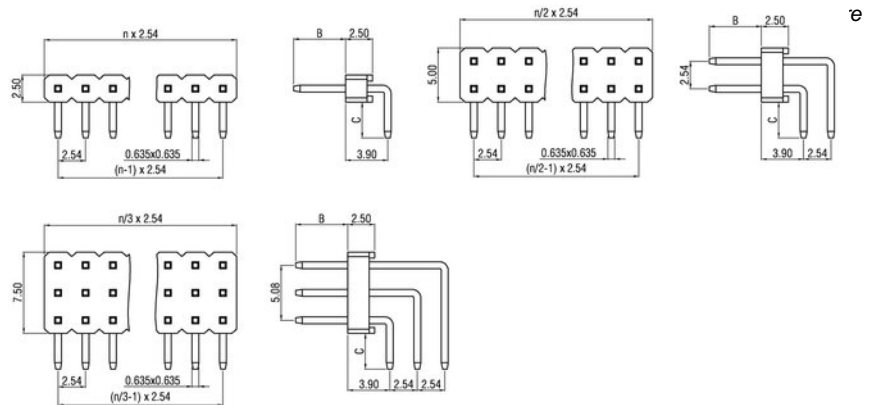
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{DC}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 340 348 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*
146	12	010	00
Thermisch gerissene Kontakte <i>Electro-strictioned contacts</i>	12 B=3,50 C=3,30mm	001-050 Einreihig <i>Single row</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i>
146 Einreihig <i>Single row</i>	13 B=4,80 C=3,30mm	004-100 Zweireihig <i>Double row</i>	10 0,25µm Gold <i>0.25µm gold plated</i>
147 Zweireihig <i>Double row</i>	14 B=6,10 C=3,30mm	009-120 Dreireihig <i>Triple row</i>	30 0,75µm Gold <i>0.75µm gold plated</i>
147 Zweireihig <i>Double row</i>	15 B=6,90 C=3,30mm		50 Verzinkt <i>Tin plated</i>
148 Dreireihig <i>Triple row</i>	16 B=9,90 C=3,30mm		Weitere Veredelungsoptionen auf Anfrage. <i>More plating options on request.</i>
	17 B=12,00 C=3,30mm		
	18 B=13,80 C=3,30mm		
	19 B=15,00 C=3,30mm		
	20 B=17,10 C=3,30mm		

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.
Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter
Techn. Informationen.

We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more dimensions on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

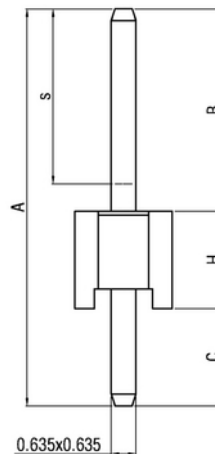
Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

Dimensions and PCB Layouts

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

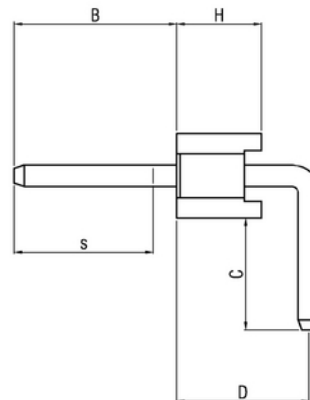
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



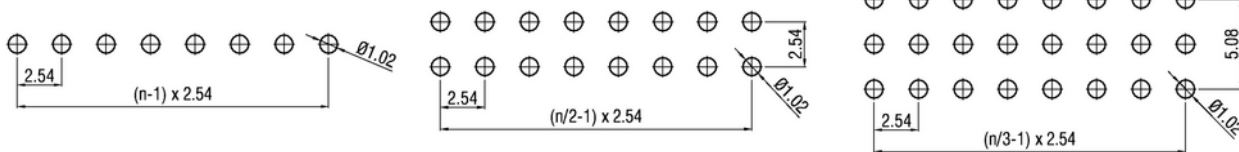
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



PCB Layouts

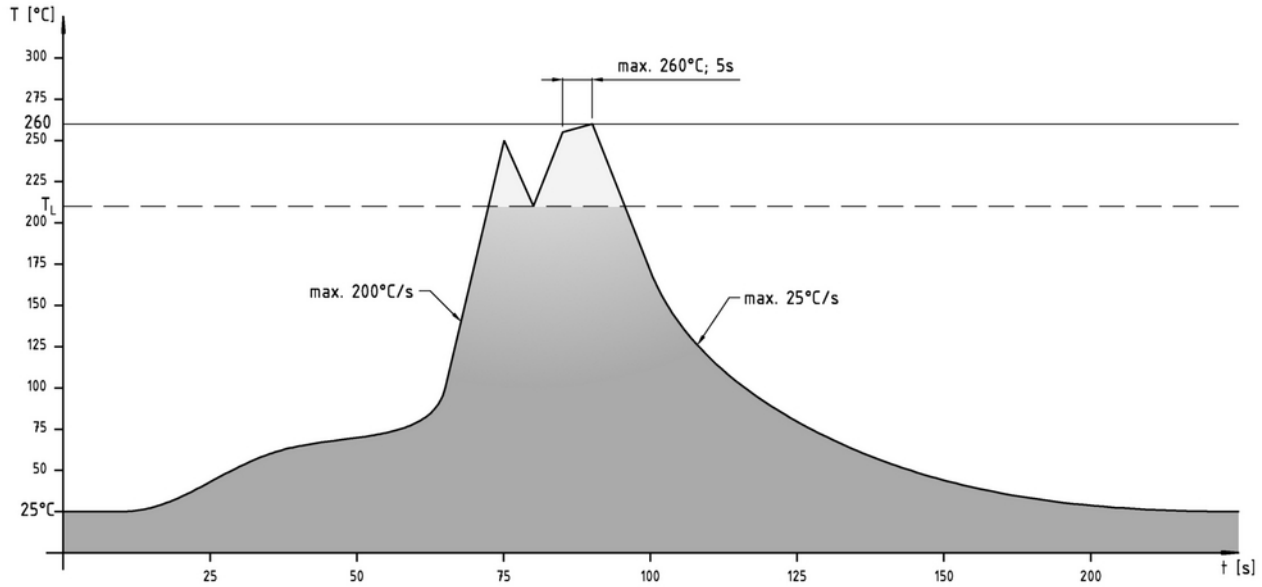


Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

